

三次元積層構造の不揮発性メモリBiCS FLASH™ の開発とキオクシアのイノベーションの紹介

我々の主要製品であるフラッシュメモリは、全てのIT技術を支える“軽量・小型で大容量の情報記憶装置”として、必用不可欠な存在です。

我々は、更なるメモリ大容量化のため、シリコンウエハ上にメモリを積み重ねる積層型メモリと積層型メモリを低コストで生産できる一括加工プロセス(Punch & Plugプロセス)の基本コンセプトを2007年に世界に先駆け発表しました。現在、世界の全主要メーカーは、Punch & Plugプロセスによる積層型のフラッシュメモリを生産しています。

本講演では、積層型のフラッシュメモリの発明経緯とPunch & Plugプロセスを支えるプラズマ応用技術を紹介いたします。

